

Check liste til oprettelse af package symbols (footprints)

Anbefaling: Generer altid komponenten således at 0,0 er der hvor pick and place punktet ønskes.

1. *Placer ben : Layout – Pins, der findes 2 typer vælg mellem*

- 1.1. Connect pins (ben som har forbindelse jf. netlisten)
- 1.2. Mechanical pins (mekaniske ben som ikke har forbindelse til netlisten)

2. *Angiv reference designator lokation og tekst*

- 2.1. Add – text
- 2.2. Class : Refdes
- 2.3. Subclass : Assembly Top
- 2.4. Klik for lokation og skriv tekst (D*) og vælg Done
- 2.5. Tilføj evt. ekstra reference designatorer til silketryk ved
 - 2.5.1. Add – text
 - 2.5.2. Class : Refdes
 - 2.5.3. Subclass : Silkscreen_Top
 - 2.5.4. Klik for lokation og skriv tekst (D*) og vælg Done
- 2.6. Tilføj evt. ekstra reference designator til monterings tegning
 - 2.6.1. Edit Copy
 - 2.6.2. Klik på tekst for copy
 - 2.6.3. Klik på tekst for placering
 - 2.6.4. Edit Change
 - 2.6.5. Indstil Class/Subclass til REF DES/DISPLAY_TOP – husk markering i new subclass
 - 2.6.6. Klik på tekst for ændring

Vigtigt : Output

Monterings tegning :

- Package Geometry/ASSEMBLY_TOP
- REF DES/DISPLAY_TOP

Silketryk :

- PACKAGE GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP
- REF DES/SILKSCREEN_TOP

Komponenter med ref des på monterings tegning og silketryk skal have

- REF DES/DISPLAY_TOP
- REF DES/SILKSCREEN_TOP

Komponenter der blot skal have ref des på monterings tegning skal kun have

- REF DES/DISPLAY_TOP

Komponenter der ikke skal have ref des på monterings tegning eller silketryk skal kun have den obligatoriske ref des (REF DES/ASSEMBLY_TOP)

3. *Lav evt. pin 1 angivelse (cirkel)*

- 3.1. Add – circel
- 3.2. Class : Package geometry
- 3.3. Subclass : Assembly Top
- 3.4. Tegn cirkel og afslut med Done

4. Tegn monterings tegning

- 4.1. Add – line/circle/rectangle/..
- 4.2. Class : Package Geometry
- 4.3. Subclass : Assembly Top
- 4.4. Tegn og afslut med Done

5. Tegn komponentens størrelse

- 5.1. Shape –Polygon/rectangular/circular
- 5.2. Class : Package Geometry
- 5.3. Subclass : Place_Bound_Top
- 5.4. Tegn og afslut med Done

6. Angiv højde på komponenten

- 6.1. Setup – Areas – Package Height
- 6.2. Klik på Place_Bound_Top
- 6.3. Angiv min og max højde og afslut med Done

7. Tegn DFA størrelse (Anvendes pt. kun i 600 serien)

Dette kan tilføjes automatisk med dfa_update.exe der ligger i tools\pcb\bin som laver en eksakt kopi af Place_Bound_Top og placerer den på Dfa_Bound_Top

- 7.1. Shape –Polygon/rectangular/circular
- 7.2. Class : Package Geometry
- 7.3. Subclass : DFA_Bound_Top
- 7.4. Tegn og afslut med Done

8. Placere en BODY_CENTER

- 8.1. Vælg Add, Text
- 8.2. Sæt class PACKAGE GEOMETRY
- 8.3. Sæt Subclass BODY_CENTER
- 8.4. Angiv koordinat eller klik
- 8.5. Skriv m for pick and place punktet (anker punktet er nederst til venstre i m'et)
- 8.6. Tryk RMB Done

Angiv evt. selv information til silketryk på Package geometry/Silkscreen_Top – anvend Add – Circle, Line, Rectangle etc.

Skal der interfaces med 3rd party netlister skal der udover at komponenten gemmes laves et device symbol – vælg File, Create Device